

产品规格书

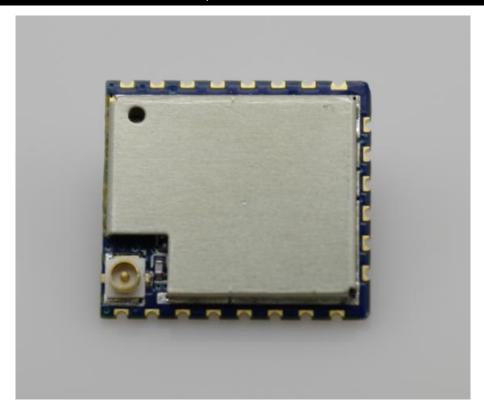
RTL8710 专业型 IOT WIFI SOC

产品简介

文件版本 01

发布日期 2016-05-16





RTL01 WIFI 模块



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

WIFI 联盟成员标志归 WIFI 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。



目录

<u>1.</u>	产品概	述	5
	1.1 特点	<u> </u>	6
	1.2 主要	要参数	7
<u>2.</u>	接口定	义	8
<u>3.</u>	外型与	尺寸	10
<u>4.</u>	功能描	述	11
	<u>4.1.</u>	MCU	11
	<u>4.2.</u>	存储描述	12
	4.2	2.1. 内置 SRAM 与 ROM	12
	<u>4.2</u>	2.2. SPI Flash	12
	<u>4.3.</u>	晶振	12
	<u>4.4.</u>	最大额定值	12
	<u>4.5.</u>	建议工作环境	13
	<u>4.6.</u>	数字端口特征	13
<u>5.</u>	RF 参数	Z	13
<u>6.</u>	功耗		14
<u>7.</u>	倾斜升	温	15
<u>8.</u>	模块安	装注意事项	16
a	参 老由	股	17



1. 产品概述

瑞昱智能互联平台 瑞昱 8710 拥有高性能无线 SOC, 给移动平台设计师带来福音, 它以最低成本提供最大实用性, 为 WiFi 功能嵌入其他系统提供无限可能。

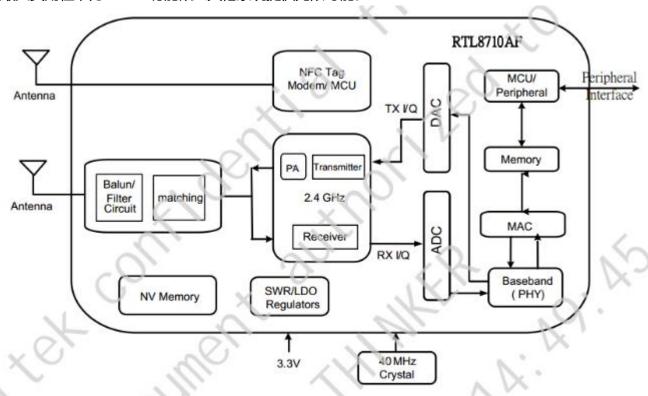


Figure 2. Single-Band 11n (1x1) and NFC Tag Solution

图 1 瑞昱 8710 结构图

瑞昱 8710 是一个完整且自成体系的 WiFi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。瑞昱 8710 在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。

另外一种情况是,瑞昱 8710 负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过 SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。



瑞昱 8710 强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备, 实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。

瑞昱 8710 高度片内集成,包括天线开关 balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模组在内的整个解决方案在设计时将所占 PCB 空间降到最低。

瑞昱 8710 的系统表现出来的领先特征有:节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD 干扰。

1.1 特点

- 802.11 b/g/n , CMOS MAC , 物理层基带
- 内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应用处理器
- 内置 TCP/IP 协议栈
- 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
- 内置 PLL、稳压器和电源管理组件
- A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
- WiFi @ 2.4 GHz , 支持 WPA/WPA2 安全模式
- 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
- 支持 Smart Config 功能 (包括 Android 和 iOS 设备)
- SPI 、UART、I2C、I2S、GPIO
- 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
- 802.11b 模式下+ 17 dBm 的输出功率
- 待机状态消耗功率小于 1.0 mW (DTIM3)
- 工作温度范围: -20℃ 85℃



1.2 主要参数

表 1 介绍了该模组的主要参数。

表 1 参数表

类别	参数	说明			
工件全粉	无线标准	802.11 b/g/n			
无线参数	频率范围	2.4GHz-2.5GHz (2400M-2483.5M)			
	CPU	ARM Cortex M3 (83MHz)			
	ROM/RAM/Flash	1MB / 512KB /1MB			
	SPI	最大支持2个			
	UART	2 个高速串口, 1 个低速串口			
	I2S	支持 4/8/16/32/64/86/44.1/88.2KHZ			
Hardware	I2C	最大支持 3 个			
Paramaters	GPIO	最大支持 17 个			
	工作电压	3.0~3.6V (建议 3.3V)			
	工作温度	-20°~85°			
	存储温度	常温			
	封装大小	17.5mm*0.8mm			
	无线网络模式	station/softAP/SoftAP+station			
	¥6+0-7-1 E	802.11g 最大为 54Mbps			
	数据吞吐量	802.11n 大为 150bps			
	加密方式	MD5/SHA/HMAC-SHA			
Software	安全机制	WPA/WPA2			
Parameters	加密类型	WEP/TKIP/AES			
raiailleteis	升级固件	本地串口烧录 / 云端升级 / 主机下载烧录			
	软件开发	支持客户自定义服务器			
	网络协议	TCP/UDP/HTTP/FTP			
	用户配置	AT+ 指令集, 云端服务器, Android/iOS APP			



2. 接口定义

详见表 2 是接口定义说明。

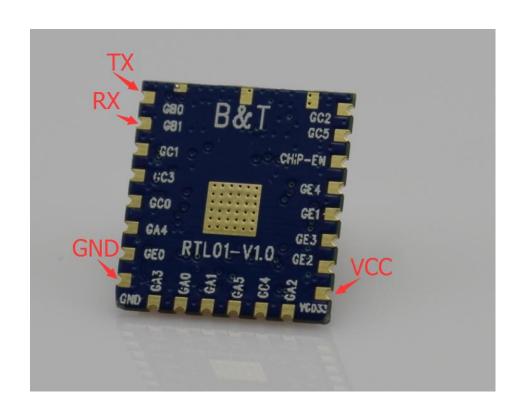


图 2 RTL01 管脚图

注意:默认的命名规则为 GC2 意为 GPIOC 的第 2 个管脚:

`



表 2 RTL01 管脚功能定义

序号	Pin 脚名称	功能说明
1	GC2	UARTO_RTS,SPIO_MOSI,I2S1_SD_TX,PCM1_OUT,PWM2,ETE2
2	GC5	I2C1_SCL,SPIO_CS2,GPIO_INT
3	CHIP_EN	Enable chip 1: enable chip; 0: shutdown chip
4	GE4	JTAG_CLK , SPIOO_CS1
5	GE1	JTAG_TDI,UART0_RTS,I2C2_SDA,SPI0_CLK,PCM0_CLK,PWM1,GPIO_INT
6	GE3	JATG_TMS,UART0_IN,I2C3_SDA,SPI0_MISO,PCM0_IN,PWM3,WKDT3,GPIO_INT
7	GE2	JATG_TDO,UART0_CTS,I2C3_SCL,SPI0_MOSI,PCM_OUT,PWM2, GPIO_INT,WKDT3
8	VDD33	3.3V
9	GA2	SD_CMD,UART2_RTS,SPI1_CLK
10	GC4	I2C1_SDA,SPI0_CS1,I2S1_SD_RX, GPIO_INT
11	GA5	SD_D1,WKDT0
12	GA1	SD_D3,UART2_CTS,SPI1_MOSI,GPIO_INT
13	GA0	SD_D2,UART2_IN,SPI1_MISO,GPIO_INT
14	GA3	SD_CLK
15	GND	GND
16	GE0	JTAG_TRST,UART0_OUT,I2C2_SCL,SPI0_CS0,PCM0_SYNC,PWM0
17	GA4	SD_D0 , UART2_OUT,SPI1_CS
18	GC0	UARTO_IN,SPIO_CSO , I2S1_WS,PCM1_SYNC,PWM0,ETE0
19	GC3	UART0_OUT,SPI0_MISO,I2S1_MCK,PCM1_IN,PWM3,ETE3,GPIO_INT
20	GC1	UARTO_CTS,SPIO_CLK,I2S1_CLK,PCM1_CLK,PWM1,ETE1, GPIO_INT
21	GB1	UART_LOG_IN,ETE1,WKDT0
22	GB0	UART_LOG_OUT,ETE0



3. 外型与尺寸

RTL01 贴片式模组的外观尺寸为 17.5mm * 16mm * 3mm (如图 3 所示)。

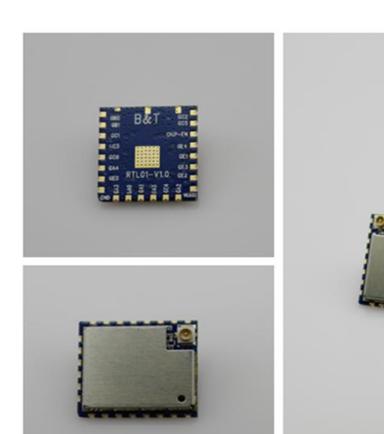


图 3 RTL01 模组外观



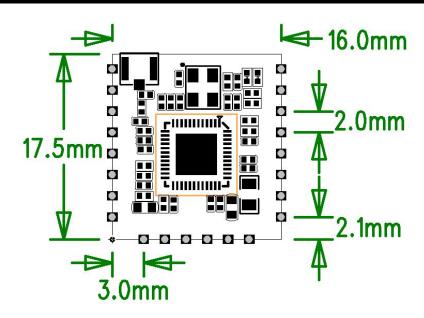


图 4 RTL01 模组尺寸平面面图

表 5 RTL01 模组尺寸对照表

K	宽	高	PAD 尺寸(底部)	Pin 脚间距
17.5mm	16mm	3 mm	0.9 mm x 1.0 mm	2.0mm

4. 功能描述

4.1. MCU

瑞昱 rtl8710af 是一个低功耗单芯片。它集成了一个 ARM Cortex M3 MCU、802.11n 无线网络控制器等于一体。它还提供了一些可配置的 GPIO 等外设。



4.2. 存储描述

4.2.1. 内置 SRAM 与 ROM

瑞昱 8710 芯片自身内置了存储控制器,包含 ROM 和 SRAM。MCU 可以通过 iBus、dBus 和 AHB 接口访问存储控制器。这些接口都可以访问 ROM 或 RAM 单元,存储仲裁器以到达顺序确定运行顺序。基于目前我司 Demo SDK 的使用 SRAM 情况,用户可用剩余 SRAM 空间为: RAM size > 48kB 。

4.2.2. SPI Flash

目前该模组内部集成的是 1MB 的 SPI Flash, 不支持外部 SPI Flash。

4.3. 晶振

目前晶体 40M, 26M 及 24M 均支持,使用时请注意在下载工具中选择对应晶体类型。晶振输入输出所加的对地调节电容 C1、C2 可不设为固定值,该值范围在 6pF-22pF,具体值需要通过对系统测试后进行调节确定。基于目前市场中主流晶振的情况,一般 40Mhz 晶振的输入输出所加电容 C1、C2 在 10pF 以内;一般 40MHz 晶振的输入输出所加电容 10pF<C1、C2<22pF。

选用的晶振自身精度需在 ±10PPM。晶振的工工作温度为 -20°C - 85°C。

晶振位置尽量靠近芯片的 XTAL Pins (走线不要太长),同时晶振走线须用地包起来良好屏蔽。 晶振的输入输出走线不能打孔走线,即不能跨层。晶振的输入输出走线不能交叉,跨层交叉也不 行。

晶振的输入输出的 bypass 电容请靠近芯片左右侧摆放,尽量不要放在走线上。

晶振下方 4 层都不能走高频数字信号,最佳情况是晶振下方不走任何信号线,晶振 TOP 面的铺通 区域越大越好。晶振为敏感器件,晶振周围不能有磁感应器件,比如大电感等。

4.4. 最大额定值

表 7 最大大额定值

额定值	条件	值	单位
存储温度		-40 to 125	°C



最大焊接温度		260	℃
供电压	IPC/JEDEC J-STD-020	+3.0 to +3.6	V

4.5. 建议工作环境

表 8 建议工作环境

工作环境	名称	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度		-20	20	85	℃
供电电压	VDD	3.0	3.3	3.6	V

4.6. 数字端口特征

表 9 数字端口特征

端口	典型值	最小值	典型值	最大值	单位
输入逻辑电平低	VIL	-0.3		0.25VDD	V
输入逻辑电平高	VIH	0.75VDD		VDD+0.3	V
输出逻辑电平低	V _{OL}	N		0.1VDD	V
输出逻辑电平高	Vон	0.8VDD		N	V

注意:如无特殊说明,测试条件为: VDD = 3.3 V, 温度为 20 ℃。

5. RF 参数

参数	典型	单位	
输入频率	2412-2	MHz	
输入电阻	5	Ω	
	802.11b	>17	dBm
输出功率	802.11g	>15	dBm
	802.11n(HT20)	>14	dBm

博安通专有和保密信息

版本 01 (2016-05-16)

版权所有 B&T中山市博安通通信技术有限公司



	802.11n(HT40)	>14	dBm
	11M	≤-76	dBm
+ \(\)	54M	≤-65	dBm
接收灵敏度	65M(HT20)	≤-64	dBm
	150M(HT40)	≤-61	dBm

表 10 RF 参数

6. 功耗

下列功耗数据是基于 3.3V 的电源、25°C 的周围温度,并使用内部稳压器测得。

- [1] 所有测量均在没有 SAW 滤波器的情况下,于天线接口处完成。
- [2] 所有发射数据是基于 90% 的占空比,在持续发射的模式下测得的。

表 11 功耗

模式	最小值	典型值	最大值	单位
传送 802.11b, ССК 11Mbps, Роит=+17dBm		87		mA
传送 802.11g, OFDM 54Mbps, Роит=+15dBm		180		mA
传送 802.11n(HT20), MCS7, Pout =+14dBm		168		mA
传送 802.11n(HT40), MCS7, Pout =+14dBm		148		mA
接收 802.11b, 包长 1024 字节, -76dBm		68		mA
接收 802.11g, 包长 1024 字节, -65dBm		68		mA
接收 802.11n, 包长 1024 字节, -64dBm		68		mA



Modem-Sleep①	15	mA
Light-Sleep②	0.9	mA
Deep-Sleep③	10	uA
正常待机	30	mA

注①: Modem-Sleep 用于需要 CPU 一直 处于工作状态 如 PWM 或 I2S 应用等。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路来省电。例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300mS,醒来 3mS 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 15mA。

注②: Light-Sleep 用于 CPU 可暂停的应用,如 WiFi 开关。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路并暂停 CPU 来省电。例如,在DTIM3 时,每 sleep 300 ms,醒来 3ms 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 0.9 mA。

注③: Deep-Sleep 不需一直保持 WiFi 连接,很长时间才发送一次数据包的应用,如每100 秒测量一次温度的传感器。例如,每300 s 醒来后需 0.3s-1s 连上 AP 发送数据,则整体平均电流可远小于1 mA。

7. 倾斜升温

表 12 倾斜升温

倾斜升温 T _S 最大值 - T _L	最大值 3℃/秒
--	----------



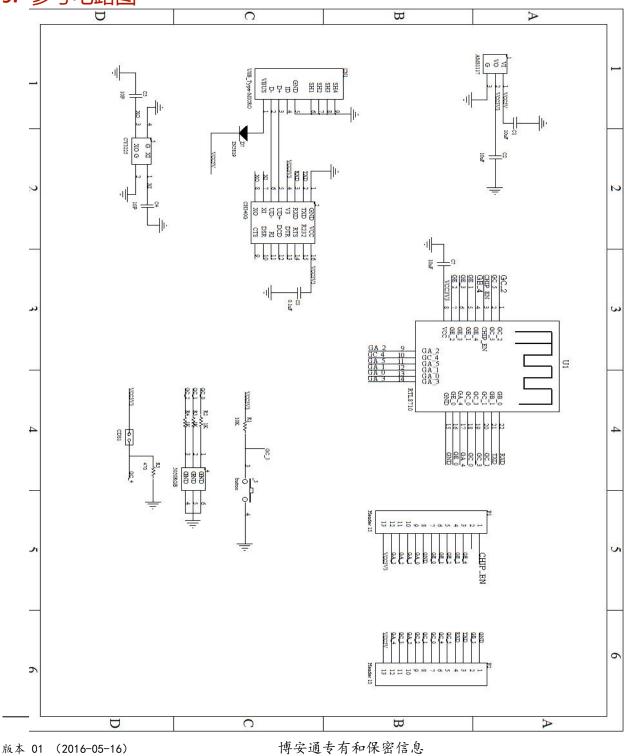
预热	
最小温度值 (T _S Min.)	150℃
典型温度值 (T _S Typ.)	175℃
最大温度值 (T _S Max.)	200℃
时间 (T _s)	60~180 秒
倾斜升温 (T _L to T _P)	最大值 3℃/秒
持续时间 / 温度 (T _L) / 时间 (T _L)	217℃/60~150 秒
温度峰值 (T _P)	最高温度值 260℃, 持续 10 秒
目标温度峰值 (Tp目标值)	260°C +0/-5°C
实际峰值 (tp) 5℃ 持续时间	20~40 秒
倾斜降温	最大值 6℃/秒
从 25℃ 调至温度峰值所需时间 (t)	最大 8 分钟

8. 模块安装注意事项

天线的辐射空间非常重要,环境的好坏会影响传输距离,金属或其他的一些例如马达,摄像头,喇叭之类的元器件会直接影响天线的性能,相当于对天线加了一层屏蔽。RTL01采用通过 ipex 座子经同轴线外接外置天线,对模块周边环境有要求,建议如下:模块下方尽量不要放置元件及高频信号走线。



9. 参考电路图



版权所有B&T中山市博安通通信技术有限公司